

한국반도체디스플레이기술학회 2024년 국내학술대회

KCSDT 2024 GUMI

Korea Conference of Semiconductor Display Technology

2024년 5월 22일(수) ~ 24일(금) 구미, 구미코

2024년 5월 23일(목), 14:00-16:00

Room C 중회의실(314B), 3층

첨단패키징 분과

[TC1] 첨단 반도체와 전력반도체 패키징 기술

좌장: 최광성 실장(한국전자통신연구원)

초청발표 TC1-1 14:00-14:20	전력반도체 소부장 기술 Material, Package and Equipment for Power Semiconductor 최윤화 제엠제코㈜
초청발표 TC1-2 14:20-14:40	Technical Support Case Study for Development of Substrate Materials, Components and Equipment for Advanced Semiconductor Packages Kyoung-min Kim, Tae-Young Lee, Sung Yong Kim, and Nam Son Park Tech University of Korea
초청발표 TC1-3 14:40-15:00	고효율 파워반도체용 Solid-state 접합소재 및 공정기술 Solid-state Bonding Material and Process for High Efficiency Power Semiconductor 오철민 한국전자기술연구원 융복합전자소재연구센터
초청발표 TC1-4 15:00-15:20	전력반도체모듈 패키징을 위한 접합 기술 Bonding Technologies for Power Semiconductor Module Packaging 윤정원 충북대학교 신소재공학과
초청발표 TC1-5 15:20-15:40	소결접합: 솔더링을 대체하는 차세대 접합기술 Sinter Bonding: The Next-Generation Bonding Technology Replacing Soldering 이종현 서울과학기술대학교 신소재공학과

한국반도체디스플레이기술학회 2024년 국내학술대회

KCSDT 2024 GUMI

Korea Conference of Semiconductor Display Technology

2024년 5월 22일(수) ~ 24일(금) 구미, 구미코

초청발표 TC1-6 15:40-16:00	반도체 패키징의 다중물리적 특성 파악을 위한 해석기법 Analysis Approaches for Understanding and Estimating Multi-physical Properties of Semiconductor Packaging 윤상원 서울대학교 전기·정보공학부
------------------------------	---
